

株式会社東京精密 2026 年度(2027 年 3 月期) 第 1 四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2026 年 8 月 4 日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された 2026 年度(2027 年 3 月期)第 1 四半期決算説明会(Web 開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. 4-6 月期の SPE 受注が想定を大幅に上回った背景の詳細を伺いたい。

- まず生成 AI を含む HPC 関連の引合が好調だったことが挙げられる。その中でもロジック向け、特に中国でのハイエンド向け需要が堅調だった。
- プローバの市場は、一部のパワーディスクリット向けを除き、ほとんどの用途で良化していると考えている。例えば、データセンタ向けアナログデバイス、PMIC などの需要も強く、一定の継続性があると思われるし、DDIC などの引合いも増えている。
- また、ダイサの受注も想定以上に良かった。能力増強投資だけではなく、シリコンフォトリソグラフィなど、新たな用途向けも確認できた。

2. 4-6 月期の生成 AI を含む HPC 関連の受注高・売上高の詳細を聞きたい。

- 4-6 月期の生成 AI を含む HPC 受注高は約 200 億円台半ば、うち 3/4 程度がロジック向け、残り 1/4 が HBM 向けとなった。
- 同期間の生成 AI を含む HPC 売上高は、SPE 売上高の 40%半ばとなり、うち 2/3 がロジック向け、残り 1/3 が HBM 向けとなった。

3. 会社は 7-9 月期の SPE 受注が、4-6 月期比で減少と想定し、その要因の 1 つとして 4-6 月期に前倒し分も含まれていた可能性を示唆しているが、詳細を聞きたい。

- 金額のイメージは無いが、前倒し案件があったものとみられる。
- 一方で、現時点では、7-9 月期の受注は、4-6 月期並みになる可能性も想定している。HBM 関連の受注が 7-9 月期に増加する可能性を想定しているためだ。

4. 会社は 2026 年度上期の HPC 関連受注の見通し(説明会資料 P13)について、前回予想対比で HBM 向けの増加率見通しを引き下げたが、その背景を聞きたい。

- 上期に見込んでいた案件が、下期(または 7-9 月期)にシフトする可能性を見込んだことによるもので、特段ネガティブな事象が発生したわけではない。

5. 各製品のリードタイムに関する情報をいただきたい。

- 仕様にもよるが、プローバは 4-8 か月程度、ダイサも同様の状況となっている。また、グラインダは 6 か月を超える状況が続いている。

6. 足許の受注高は売上高を大きく上回っている。現状をどう評価するか。

- 受注環境は非常に強く、生産能力の 1.5 倍程度の受注がある状況。

7. 会社は 2026 年度の設備投資計画を修正した。この修正の内容と、この実行によって現在のキャパシティがどれほど増加する見込みか聞きたい。

- まずプローバの生産拡大のため、主力工場である飯能工場(埼玉県飯能市)に保管している部材を外部倉庫へ移管し、そのスペースを生産場所へ転用する。これに係るユーティリティ改造費用などを折り込んでいる。今年度中には完了する見込み。
- 並行して、社内の人財のうち 100 名程度を生産応援に配置した。
- この 2 つのアクションはキャパシティを段階的に高める。2027 年度初には現在比で 1.2 倍程度になる効果があると思われる。
- これとは別に、飯能工場の近隣に新工場を建設する計画を進めておりこれに係る設備投資予算を追加した。延床面積をベースにすると新工場は飯能地域での生産スペースを 1.5 倍にするので、さらなるキャパシティ増加が見込まれる。

8. 会社は 2026 年度通期業績予想を上方修正した。売上高は中期経営計画(2025 年度-2027 年度)の定量目標を超過する一方で、営業利益予想は定量目標に達していない。利益予想の前提について、前回予想からの変化があれば聞きたい。

- 前提は前回策定予想から大きな変化はない。すなわち付加価値を有する高精度温度制御機能付きプローバの販売増加による利益率の改善が前提となる。
- また、グラインダで現在の PG(Polish Grinder)ベースの製品の販売から、より付加価値の高い HRG(High Rigid Grider、高剛性グラインダ)への移行による利益率の改善、さらにダイサの販売数量増による利益拡大を想定している。
- また、前述の飯能工場の設備投資に関連した費用増、人件費の増加などを業績予想に新たに織り込んでいる。もっとも経費は、計画満額を予想に織り込んでいるため、実績との差が生じる可能性がある。
- 新たな業績予想では半導体の通期営業利益率は 25-6%となる前提となる。

9. 総じて、受注高の成長に対して、売上高の成長が限定的であると感じる。

- 売上高成長に対するリスクは人員・生産スペースのみではない。部材調達に関するリスクを想定している。
- 修正後業績予想における売上高は、生産に必要な部材の確保が確定できるもののみ織り込んでいる。言い換えれば、更なる部材確保ができれば、生産能力は売上高予想に対してもう数十億円はあることになる。
- SPE 業界は変動が大きく、常に生産力に余剰を持った体制を維持することは難しい。とはいえ、長期的に市場は拡大することは確実と考えている。そのために当社は長期の設備投資計画を有しており、前述の飯能新工場の建設だけでなく、2030 年度を目途に東京都八王子に新工場を建設する計画を具体化している。

10. Hybrid Bonding 用グラインダの事業機会に関して、アップデートがあれば共有いただきたい。

- 5 月説明会時点での見方(NAND 向けで、2026 年度下期以降 量産用装置の受注を期待、2027 年度後半からの出荷実現を期待) から大きな変更は無い。
- 当社は対象顧客に対して評価機を出荷しており、2026 年度も一部の評価機で顧客の購入基準を満足し、売上計上されることを期待している。
- なお、名古屋工場は、この Hybrid Bonding 用グラインダの生産強化を目的として立ち上げ、現在は AI パッケージング用グラインダの生産に充てているが、こちらもフル生産体制に移行するための設備投資・人員増強を進めている。

11. プラズマダイシングについて、現況を伺いたい。

- 当社はプラズマダイシングの一連の工程における、グルービング工程に適用するマシンを提供している。
- 現状、量産適用が拡大しているという認識はなく、各社が様々な評価を行っている段階と認識している。

以上